

正本

檔 號：
保存年限：

新北市政府 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161號4樓
承辦人：張承昕
電話：(02)29603456 分機5539
傳真：(02)29649939
電子信箱：AQ3674@ntpc.gov.tw



23666

新北市土城區中華路1段36號4樓

受文者：台灣區表面處理工業同業公會

發文日期：中華民國113年5月9日
發文字號：新北府經企字第11308486271號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明四

主旨：轉知財團法人台灣設計研究院(下稱設研院)檢送辦理「2024金點設計獎」(下稱設計獎)獎賽介紹及報名簡章各1份，敬請貴機關及所屬單位踴躍參加，請查照。

說明：

- 一、依據113年5月2日台設字第1131001213號函辦理。
- 二、旨揭設計獎係由經濟部指導，經濟部產業發展署主辦，設研院執行之國際級設計獎賽，旨在促進設計產業發展，鼓勵企業重視設計與研發，以設計力增加品牌的附加價值，更為消費者與市場提供優質設計的認證，進而提升全民對於設計價值與設計美學的認知，共同創造美好生活品質。

三、參賽資訊如下：

(一)報名資格：已完成專案之相關衍伸設計物、已商品化且上市銷售之作品，或已完成、啟用之空間或整合設計作品，申請單位可為公部門、廠商業者或設計團隊。

(二)報名日期及費用：

- 1、早鳥報名：自本(113)年4月11日起至6月7日17時00分止，每件新臺幣3,500元整。
- 2、一般報名：自本(113)年6月7日17時01分起至6月26日17時00分止，每件新臺幣5,000元整。



台灣區表面處理工業同業公會	
收文	113061 號
民國	113年 5月 2日

(三)報名方式：採網路報名，請逕自設計獎官網會員專區
(https://goldenpin.org.tw/zh-TW/users/sign_in)辦理線上報名。

四、旨揭「金點設計獎介紹」、「報名簡章」及說明一「函文」之相關附件已放置google雲端硬碟內，請逕自於連結
(<https://reurl.cc/QRW1gq>)下載。

五、倘有任何異動，將於設計獎官網
(<https://goldenpin.org.tw>)公告，如有問題請逕洽設研院窗口電郵至gpaward@tdri.org.tw信箱。

正本：各公(協)會
副本：

市長侯友宜



本案依分層負責規定授權經濟發展局局長決行